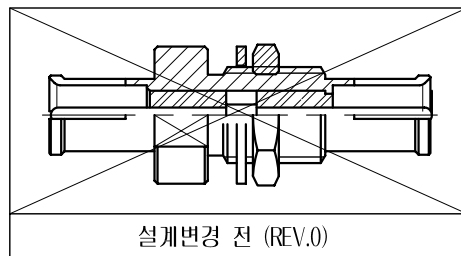
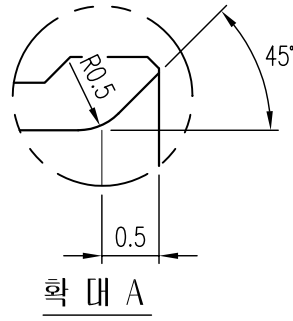
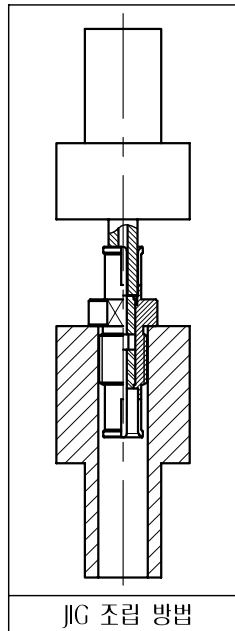
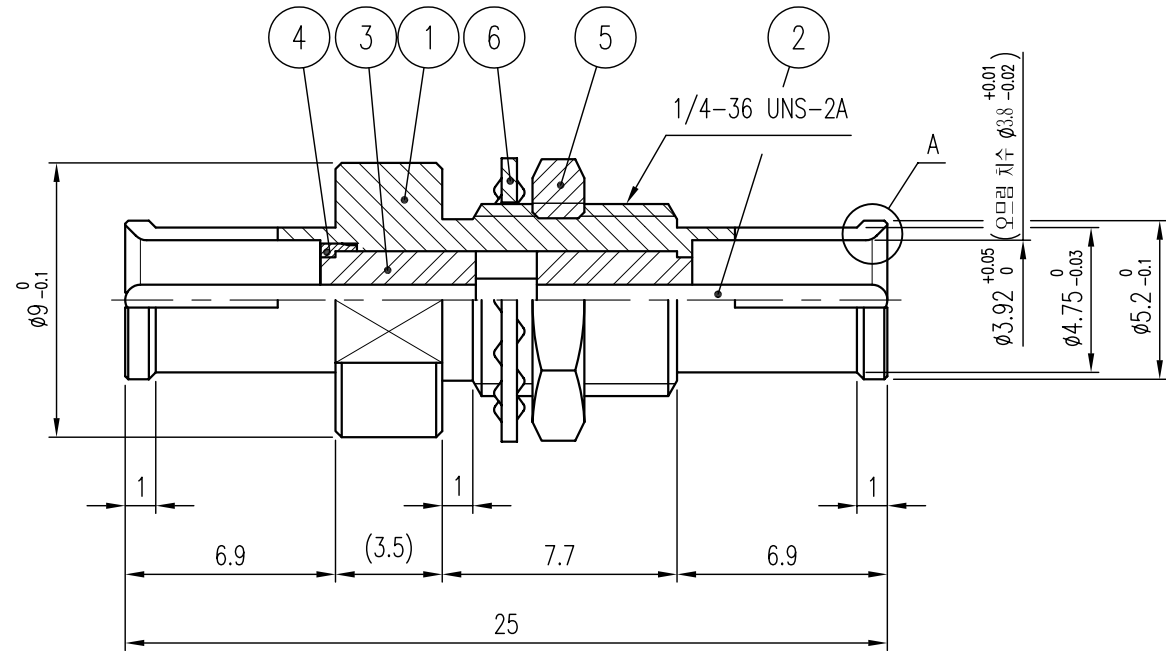
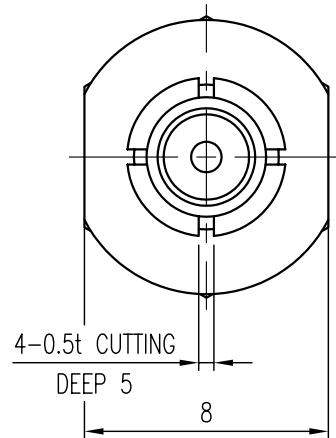


개 ST											수 정 내 용				
											부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)											1	부착물 개선(설비No.연구2005-264) (TEFLON 배심 방지-구조변경,고정 경 추가)	김은희	최종락	2005. 11. 11.
ST(개선)											▲				

* 조립 주 기

1. 지그 KJ2-067을 사용하여
고정 링 조립 할 것. (아래 그림 참조)



△ 1	6	WASHER	1	MBsBD	Gold Plate(무광)	DWA00005-5/4
	5	NUT	1	MBsBD	Gold Plate(무광)	DNT00025-5/4 (N2002)
	4	고정 RING	1	MBsBD	Gold Plate(무광)	DSR00049-5/1 (LB005)
	△ 1	3	INSULATOR	± 2	TEFLON	DIN00889-N/1 (HB070)
	△ 1	3	INSULATOR	1	TEFLON	HB068
	2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00929-5/1 (EB055)
	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate(무광)	DBD01159-5/1 (DB097)
	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

대체가능재질	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공동공치 소수 각도 분수 ± 0.1	년월일	2003. 12. 8.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
	승인					
재질	검도			도명	D/SUB-BA-PP VER.1	
	제도					
열처리	작성부서 연구소			A4	도번 AD00343-7/1	
보호피막처리	척도 4/1	단위 mm	총량		K385-706-000	